

証券コード：6314

平成28年3月期
決算説明資料



株式会社 石井工作研究所
ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

<http://www.i-kkco.jp>

決算説明資料の構成

1. 平成28年3月期決算概要
2. 平成28年12月期通期業績予想
3. 会社概要
4. 技術・新製品開発

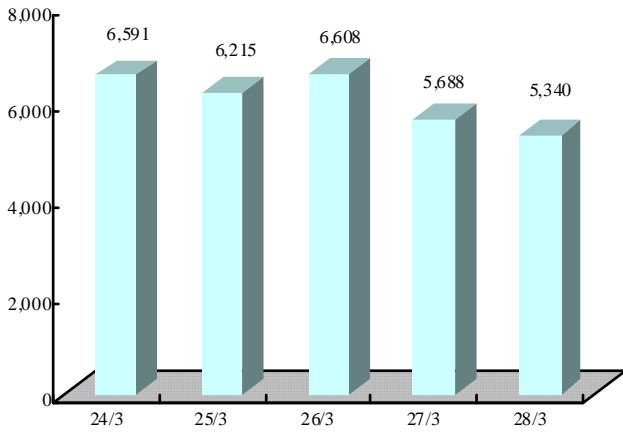


1. 平成28年3月期 決算概要

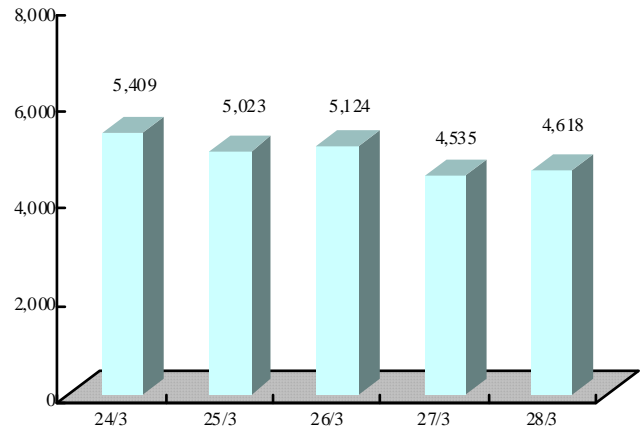


財務状態 Financial Condition

総資産 Total assets (百万円/¥Millions)

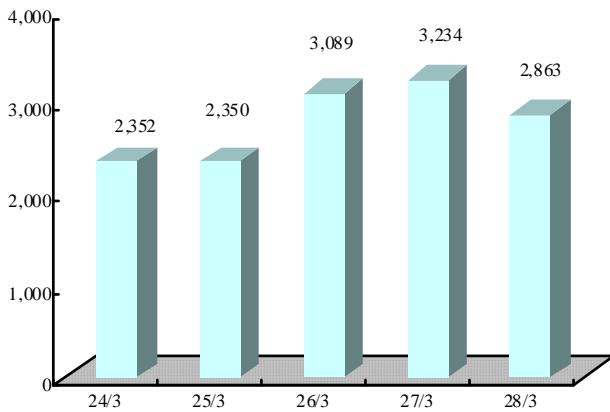


純資産 Net Assets (百万円/¥Millions)

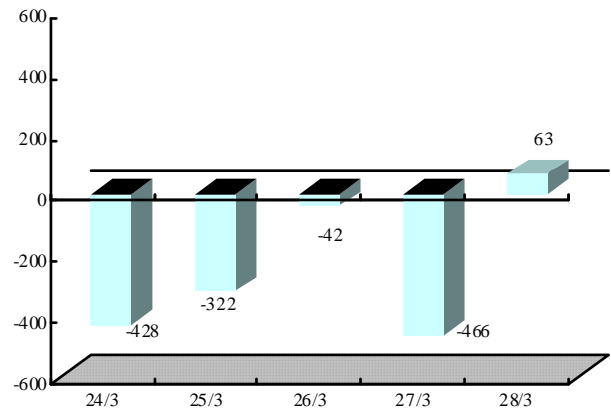


業績推移 Operating results

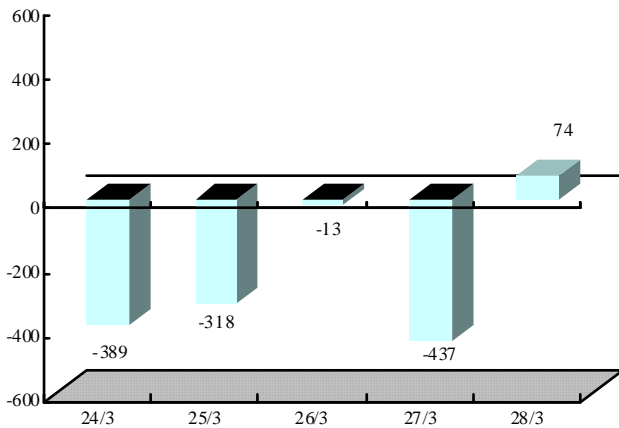
売上高 Net sales (百万円/¥Millions)



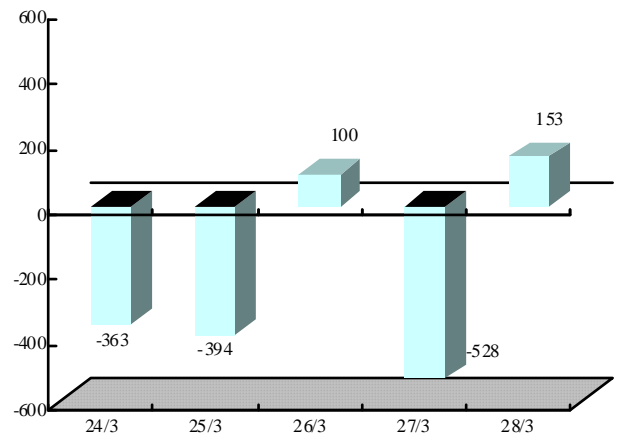
営業利益又は営業損失 Operating income or loss (百万円/¥Millions)



経常利益又は経常損失 Ordinary income or loss (百万円/¥Millions)



当期純利益又は当期純損失 Net income or loss (百万円/¥Millions)



セグメント別販売実績

セグメントの名称	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	前年同期比(%)
半導体関連事業(千円)	2,848,180	92.6
不動産・建築関連事業(千円)	15,529	9.8
合計(千円)	2,863,710	88.5

(注)1. 前事業年度及び当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、当該割合が100分の10未満の場合は記載を省略しております。

相手先	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)		当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
第一実業(株)	1,352,514	41.8	1,353,642	47.3
三菱電機(株)	506,188	15.7	301,593	10.5

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

セグメント別受注状況

セグメントの名称	受注高 (千円)	前年同期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同期比 (%)
半導体関連事業	2,955,266	105.5	1,213,396	109.7
不動産・建築関連事業	15,643	13.3	634	121.8
合計	2,970,909	101.8	1,214,031	109.7

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



2. 平成28年12月期通期業績予想

第39期(平成28年12月期)の利益計画

a. 利益計画表

項目	期別		第38期 (28年3月期)		第39期予想 (28年12月期)		増減 千円
	千円	%	千円	%	千円	%	
売上高	2,863,710	100.0	2,470,000	100.0	—		
売上原価	2,397,576	83.7	1,997,000	80.9	—		
売上総利益	466,133	16.3	473,000	19.1	—		
販売管理費及び一般管理費	402,860	14.1	373,000	15.1	—		
営業利益	63,273	2.2	100,000	4.0	—		
営業外収益	21,143	0.7	17,000	0.7	—		
営業外費用	10,256	0.4	7,000	0.3	—		
経常利益	74,160	2.6	110,000	4.5	—		
特別利益	116,029	4.1	142,000	5.7	—		
特別損失	331	0.0	—	—	—		
税引前当期純利益	189,857	6.6	252,000	10.2	—		
法人税及び住民税	5,566	0.2	26,000	1.1	—		
法人税等調整額	30,822	1.2	10,000	0.4	—		
当期純利益	153,469	5.2	216,000	8.7	—		

b. 売上高のセグメント別内訳

(単位:千円)

セグメントの名称	期別		第38期 (28年3月期)		第39期予想 (28年12月期)		増減
	千円	%	千円	%	千円	%	
半導体関連事業	2,848,180	99.5	2,468,000	99.9	—		
不動産・建築関連事業	15,529	0.5	2,000	0.1	—		
合計	2,863,710	100.0	2,470,000	100.0	—		

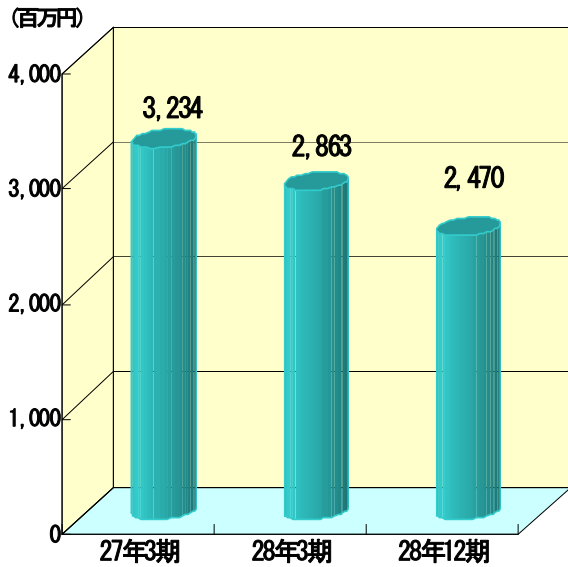
(注)第39期は決算期の変更(3月31日を12月31日)に伴い、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの9ヶ月の変則決算となる予定により、対前年増減は記載しておりません。

本資料に掲載されている業績予想、見通し、事業戦略につきましては、現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

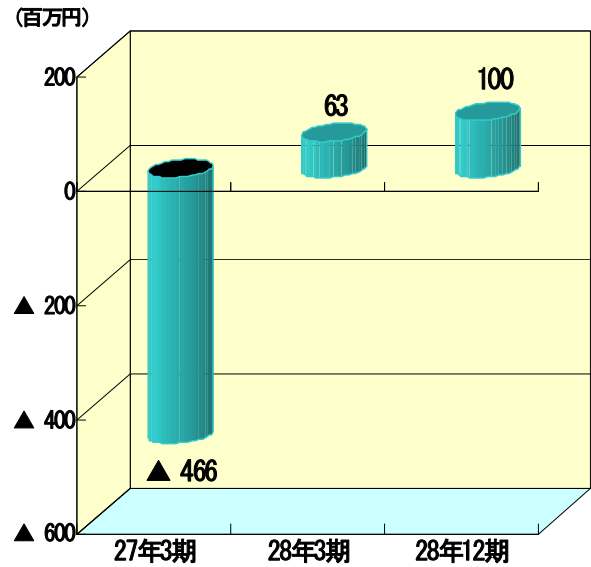


28年12月期の目標

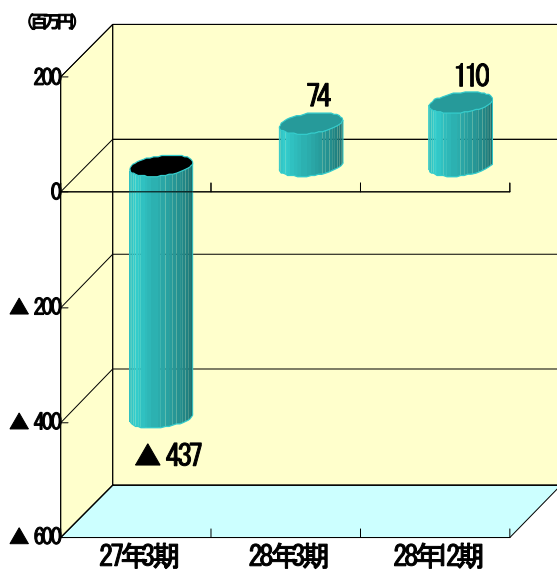
売上高



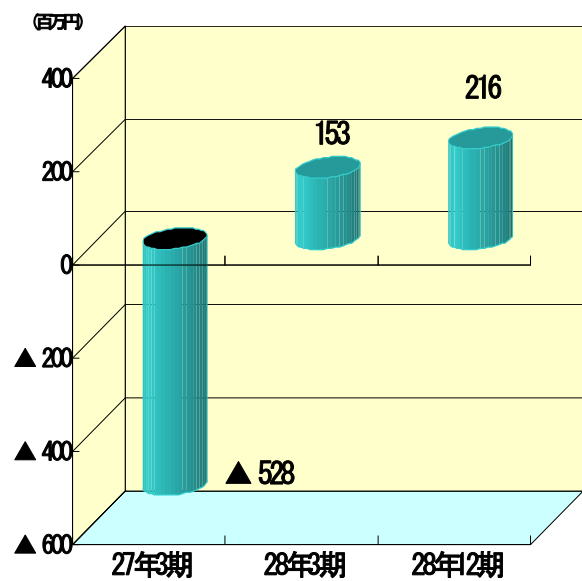
営業利益



経常利益



純利益





3. 会社概要

会社の概要

(平成28年3月31日現在)

商 号 株式会社 石井工作研究所
 (英訳名 ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION.)
 本 店 大分県大分市東大道二丁目5番60号
 設立年月日 昭和54年(1979年)1月5日
 事業内容

セグメント の名称	区 分	主 要 営 業 品 目
半 導 体 関 連 事 業	半 導 体 関 連 製 造 装 置 及 び 金 型	リード加工機 (BGA・CSP個片カット装置を含む) リード加工金型
	加 工 部 品	プラスチック成型加工品 プレス加工品、金属加工部品
	電 装 品	マイクロコンピューター、電装装置
	そ の 他	購入品、補修サービス
不動産・建築 関 連 事 業	マ ン シ ョ ン 及 び 住 宅	個人住宅・住宅用ホームエレベータ 太陽光発電装置

資 本 金 1,186,300,000 円
 株式の状況 会社が発行する株式の総数 30,000,000株
 発行済株式総数 7,800,000株
 1単元の株式数 100株

決 算 期 3月31日(年1回)
 役 員 代表取締役社長 佐 藤 一 彦
 専務取締役 中 野 雅 一
 取締役 重 松 秀 信
 取締役 時 枝 典 生
 取締役 村 井 雄 司
 取締役 岐 部 和 久
 監査役(常勤) 衛 藤 良 一
 監査役 姫 野 昭 雄
 監査役 伊 東 徳

従 業 員 数 232名
 (従業員には、臨時従業員(準社員)を含んでおりません。)

主要取引銀行 株式会社 大 分 銀 行 本 店
 株式会社 三井住友銀行 大分支店
 三井住友信託銀行株式会社 大分支店

大 株 主

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況	
	持 株 数	持 株 比 率
モバイルクリエイイト株式会社	3,181 千株	40.93 %
石井工作研究所 従業員持株会	887	11.42
石 井 光 明	150	1.93
石 井 仁 海	139	1.79
日本証券金融株式会社	107	1.38
松井証券株式会社	86	1.11
MORGAN STANLEY&CO. LLC	74	0.96
株式会社SBI証券	64	0.83
石 井 貞 憲	60	0.78
渡 邊 俊 雄	50	0.64

(注) 持株比率は、自己株式(28,006株)を控除して計算しております。

会社の沿革

年 月	概 要
昭和 54 年 1 月	(株)石井工作研究所設立(資本金 10,000 千円)。前身である個人企業石井工作研究所より人員その他すべてを引継ぎ、精密金型、半導体関連製造装置の開発、設計、製造、販売を主業務とした事業を開始。本社及び本社工場(旧大分工場)を大分県大分市東大道二丁目1番3号に置く。
昭和 54 年 6 月	金属及び非金属材料販売を行なうため丸普通商(株)設立。
昭和 55 年 10 月	数値制御による機械加工を集約するため(株)大分エヌシーセンター設立。
昭和 56 年 4 月	熊本及び福岡での販売を強化するため熊本県熊本市に熊本営業所開設。
昭和 56 年 5 月	当社及び関連会社の不動産管理のため大分県大分市に(有)石井工研産業設立(後、株式会社へ組織変更)。
昭和 58 年 12 月	丸普通商(株)を(株)九栄システム(現北九州工場)に商号変更するとともに本社を北九州市門司区に移転。
昭和 59 年 1 月	業容の拡大と合成樹脂製品製造、販売のため、大分県テクノポリス地域の指定を受けた大分県杵築市に杵築工場開設。
昭和 60 年 2 月	関西及び関東以北での販売を強化するため、大阪事務所を大阪市北区に東京事務所を東京都新宿区に開設。
昭和 61 年 3 月	半導体組立工程の5工程(①リードフレームからの切り離し ②足の折り曲げ ③性能テスト ④製品名などの印刷 ⑤分類)を一貫処理できる半導体自動組立装置「PTMD300」を(財)大分県高度技術開発研究所をはじめ、大分工業高等専門学校や大分大学と共同開発。
昭和 61 年 8 月	半導体製造用の低騒音、超小型のNCモータープレスの「ソフトプレス」を開発。
昭和 61 年 11 月	日本国内での販売を強化し、新製品販売促進のため東京晴海での半導体製造装置展示会“セミコン・ジャパン 86”に初めて出展。
平成 3 年 10 月	経営の合理化と経営効率を図るため、(株)大分エヌシーセンター、(株)九栄システム及び(株)石井工研産業を吸収合併。
平成 4 年 3 月	当社の「ソフトプレス」を使った半導体製造の後工程一貫製造装置が、「第4回中小企業優秀新技術・新製品賞」(協和(現りそな)中小企業振興財団・日刊工業新聞共催)を受賞。
平成 4 年 9 月	「IC検査用画像処理装置」を開発。
平成 5 年 7 月	アメリカでの世界最大の半導体製造装置展示会“セミコン・ウエスト 93”に初めて出展。
平成 5 年 9 月	本社ビル完成。
平成 7 年 4 月	大阪事務所及び東京事務所を各々営業所に名称変更。
平成 8 年 8 月	当社株式を日本証券業協会の店頭売買有価証券として登録。
平成 9 年 2 月	ISO9001 認証取得及びCEマーキングライセンス権取得。
平成 12 年 8 月	ISO14001 認証取得。
平成 13 年 6 月	北九州工場を北九州市小倉北区に土地・建物を取得して移転。
平成 13 年 8 月	不動産事業を開始。
平成 14 年 1 月	浄水事業を開始。
平成 15 年 11 月	大分曲工場第一期工事完成。
平成 16 年 12 月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成 17 年 12 月	大分曲工場第二期工事完成。
平成 18 年 2 月	大分工場、大分羽田工場の大分曲工場移転完了。
平成 18 年 7 月	本社所在地を大分県大分市東大道二丁目5番 60 号に住所表示変更。
平成 21 年 4 月	北九州工場及び大阪営業所を閉鎖。
平成 21 年 6 月	東京営業所を東京都港区の新築自社店舗に移転。
平成 22 年 4 月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
平成 25 年 4 月	閉鎖していた北九州工場を売却。
平成 25 年 7 月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード)に上場。
平成 26 年 5 月	当社創業者石井見敏氏逝去。
平成 27 年 1 月	モバイルクリエイイト株式会社が筆頭株主及びその持分法適用会社となる。
平成 27 年 5 月	大分羽田工場を売却。
平成 27 年 10 月	熊本営業所を閉鎖。東京営業所を移転。
平成 28 年 3 月	モバイルクリエイイト株式会社による当社への友好的TOBが実施され、同社の子会社となる。 (当社株式は、引続き東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード)に上場維持)



営業所及び工場

① 本 社 大分県大分市東大道二丁目5番60号

② 営 業 所

東京営業所 東京都港区

③ 工 場

大分曲工場 大分県大分市

杵築工場 大分県杵築市



4. 技術・新製品開発

オフィスが半導体工場に

ミニマルから始まる日本の先進技術

ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION

超小型生産システムの開発構想から生まれたミニマルファブ
 革命的な超小型半導体製造装置により多品種少量生産に適した生産システム

生産工程 Process Start▼

ミニマル生産ラインのダイボンダ、インクジェットプリンターの開発を行っています。

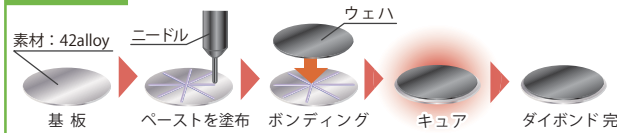
ダイボンダ

Die Bonder

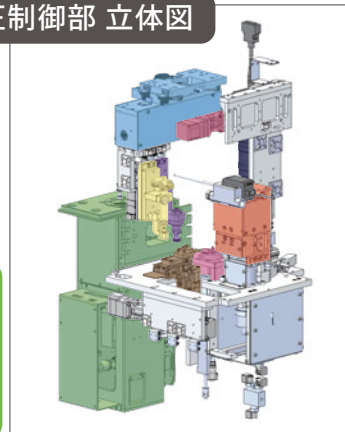
ミニマルダイボンダ

ミニマルサイズを実現した超コンパクトダイボンダ
 ・リニアモータ制御によりボンディング機構の小型化と加圧制御の容易化を実現しました。

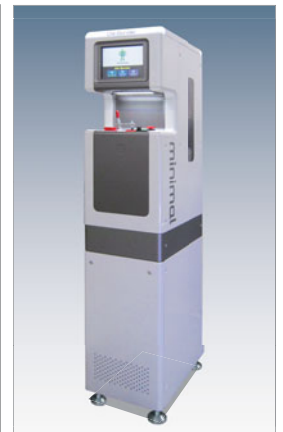
動作フロー



加圧制御部 立体図



DBミニマル装置写真



モールド樹脂成形

レーザービア

デスピア

Cu シード層

Cu メッキ

レジスト塗布

マスクレス露光

現象

Cu エッチング

レジスト除去

インクジェットプリンター

はんだボール搭載

はんだリフロー

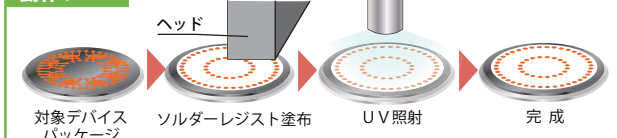
Finish

Ink Jet Printer

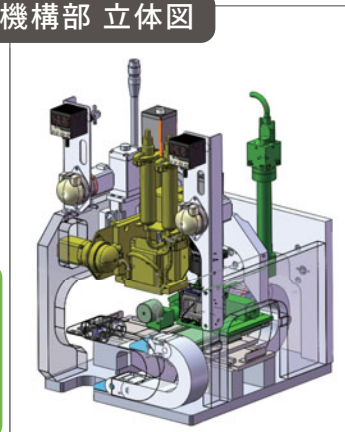
ミニマルインクジェットプリンター

ソルダーレジストインクをオンデマンド塗布・成膜
 ・ソルダーレジストをインクジェット塗布・成膜させる装置を極限まで小型化して、ミニマルファブ規格のコンパクトな筐体に納めました。

動作フロー



IJP 機構部 立体図



IJPミニマル装置写真



本資料に関するお問い合わせ



株式会社 石井工作研究所
ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

IR 担 当 者

TEL : 097-544-1001

E-mail : tokieda@i-kk.co.jp